

证券代码：688362

证券简称：甬矽电子

### 甬矽电子（宁波）股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：2025-001

|               |   |
|---------------|---|
| 投资者关系活动类别     | <input checked="" type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议<br><input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 业绩说明会<br><input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 路演活动<br><input checked="" type="checkbox"/> 现场参观<br><input type="checkbox"/> 其他（ <u>电话会议</u> ）     |
| 参与单位名称及人员姓名   | 中信证券、杭州金投产业基金、宁波宏阳投资、宁波三登投资、上海品投投资、海南星火基金、浙江富浙基金、浙江泽芝资本、杭州附加值投资、杭州博投资、上海嘉御资本、桐乡新都金控、杭州上研科领基金、中财招商投资以及个人投资者  |
| 时间            | 2025年1月   |
| 地点            | 公司会议室   |
| 上市公司接待人员姓名    | 董事会秘书、副总经理李大林先生   |
| 投资者关系活动主要内容介绍 | <p><b>1、客户在同一芯片上选择供应商时，是选择多个供应商共同供应还是单一供应商独供？当前公司在客户供应链中处于什么地位？</b></p> <p>客户通常选择多供的方案以应对潜在的供应链风险。目前公司是一些头部客户的第一供应商；身为客户一供，公司可以更好的承接客户新产品的研发任务，而新产品更高的附加值也将正向促进公司的毛利率水平。</p> <p><b>2、目前半导体及封测行业处于什么周期？</b></p> <p>从半导体的传统周期角度，2023年属于行业去库存阶段，随着去库存周期结束，2024年许多客户业绩高速增长，公司也伴随客户一同成长；从科技发展的角度，自2023年初</p> |

Chat GPT 出现后，AI 行业迅速发展，目前大模型公司以及硬件公司都在探索 AI 落地路径，包括智能驾驶、AI 玩具、AI 机器人等方面，未来应用落地对半导体行业需求量的拉动较为可观。

**3、系统级封装主要应用于成熟制程上，Bumping 主要应用于先进制程上吗？**

芯片封装形式不完全取决于晶圆制程，更取决于客户的需求和实际应用场景。

**4、国外设备引进是否受到半导体制裁政策的影响？与国内设备厂商的合作情况？**

公司的设备引进暂未受到制裁政策影响，公司现有设备以进口为主，同步导入国产设备进行 demo。国内的头部设备供应商都是公司的战略合作伙伴。

**5、SoC 行业竞争格局？**

以 SoC 行业上市公司为例，各家芯片公司都是差异化竞争，应用领域有所不同。公司会持续和行业头部客户保持合作关系，对于行业前景保持乐观态度。

**6、公司的核心优势？**

公司的创始团队拥有 20 多年的行业经验，具备丰富的封装技术和管理经验。公司在先进封装领域具有较为突出的技术先进性和工艺优势，自动化水平高，设备选型和品质管控精细，能够与客户紧密配合，提供高价值的封装解决方案。公司在品质良率、产品交期以及成本控制方面都取得了客户的认可。

**7、下游应用市场的景气度？**

IoT 领域，新的应用场景不断涌现，芯片应用范围越来越广，未来成长可观；PA 领域有所下滑，但 PA 公司的竞争力在增强；车规领域，智能驾驶应用比例会持续提高，增量空间巨大，目前智驾芯片以海外大厂为主，国内设计公司也

|          |   |
|----------|---|
|          | <p>在奋力追赶。</p> <p><b>8、公司营收增长，但利润未体现增长的原因？</b></p> <p>影响利润的主要因素包括折旧摊销、管理费用、财务费用。在折旧方面，二期大量投资所产生的折旧先于营收体现，在规模效应没起来之前会对毛利润造成一定影响；在管理费用方面，二期落成后，公司进行人才储备导致管理费用大幅增长；在财务费用方面，公司成立时间较晚，银行贷款等债权融资较多，未来随着公司经营活动现金流累积、股权融资增加，资产负债表将进一步优化，进而降低财务费用率。整体而言，随着公司营收规模的增长，规模效应逐渐体现，会对毛利率及期间费用率均有正向影响。</p> <p><b>9、一期和二期产品情况及稼动率情况？</b></p> <p>公司整体稼动率处于相对饱满的状态。一期以 SiP 产品为主，稼动率持续维持高位，二期以先进封装产品为主，产能持续爬坡。</p> <p><b>10、2.5D 封装布局情况？</b></p> <p>公司目前在 2.5D 方面的布局目前已经通线，核心设备已经全部 move-in，正在积极与客户对接。</p> |
| 附件清单（如有） | 无   |
| 日期       | 2025 年 1 月 21 日   |